

雷射切割技術人員職能基準

職能基準代碼		MPM7223-005v1			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	雷射切割技術人員		
所屬 類別	職類別	製造 / 生產管理		職類別代碼	MPM
	職業別	金屬工具機設定及操作人員		職業別代碼	7223
	行業別	製造業 / 金屬製品製造業		行業別代碼	C2511
工作描述		從事金屬雷射切割相關技術工作 ^{【註1】} 及切割機維修作業			
基準級別		3			

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
T1 工作圖判讀	T1.1 圖樣及材料表檢查		P1.1.1 依照工作圖面及材料需求,選用及確認合適的雷射切割組件規格。	3	K01 材料規格 K02 識圖與製圖 K03 公差配合 K04 表面織構符號(加工符號)	S01 工作圖判讀
	T1.2 加工資訊蒐集		P1.2.1 統整加工資訊的蒐集與分類,並運用於加工作業。 P1.2.2 學習運用新技術於工作領域。	3	K05 科技發展概論	S02 加工資訊蒐集
T2 切割模擬測試與雷射切割	T2.1 料件雷射切割機台模擬測試	O2.1.1 料件測試報告	P2.1.1 評估切割料件後,以進行光路架設確認電腦模擬操作。 P2.1.2 進行光路架設完成模擬並進行驗證。	3	K06 雷射加工特性分析方法 K07 光學料件概論 K08 光路架設概論	S03 文書撰寫能力 S04 雷射切割模擬測試操作

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
	T2.2 切割機台調校		P2.2.1 機台原點復規及定位工作原點。 P2.2.2 判定機台或境頭的堪用程度。 P2.2.3 設定氣體壓力進給速度切削功率等切割條件。	3	K09 切割機台調校概論	S05 切割機台操作能力
	T2.3 雷射切割打樣操作	O2.3.1 成品打樣 O2.3.2 打樣測試報告書	P2.3.1 依據客戶提供產品各種材質，進行材料切割條件的判定。 P2.3.2 根據實驗測試結果，分析實驗數據。 P2.3.3 根據擬定的實驗規劃，執行產品打樣及測試並產出測試報告書。	3	K06 雷射加工特性分析方法 K07 光學料件概論 K08 光路架設概論 K10 職業安全衛生相關規範 K11 品質管制與品質意識	S06 料件打樣操作 S03 文書撰寫能力
	T2.4 雷射切割製程操作		P2.4.1 依據工作圖面進行工作分析與操作。 P2.4.2 依製程進行實務切割作業。	3	K06 雷射加工特性分析方法 K07 光學料件概論 K08 光路架設概論 K10 職業安全衛生相關規範 K11 品質管制與品質意識 K12 工作分析 K13 精密量測	S07 製作夾具與治具 S08 雷射切割操作 S09 個人防護裝備使用
T3 切割機台保養作業	T3.1 切割機台保養與維修		P3.1.1 依雷射切割製程進行檢討與改善。 P3.1.2 按照雷射切割組件或模組，進行維護保養作業。	3	K14 機具維修與保養概要	S10 切割機台維修與保養技能
	T3.2 異常狀況處理		P3.2.1 排除雷射切割生產製作產生的問題。	3	K15 問題分析與探討	S11 異常狀況初步研判與處理

職能內涵 (A=attitude 態度)

A01 自我管理：設立定義明確且實際可行的個人目標；對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。

A02 主動積極：不需他人指示或要求能自動自發做事，面臨問題立即採取行動加以解決，且為達目標願意主動承擔額外責任。

A03 團隊意識：積極參與並支持團隊，能彼此鼓勵共同達成團隊目標。

A04 壓力容忍：冷靜且有效地應對及處理高度緊張的情況或壓力，如緊迫的時間、不友善的人、各類突發事件及危急狀況，並能以適當的方式紓解自身壓力。

A05 正直誠實：展現高道德標準及值得信賴的行為，且能以維持組織誠信為行事原則，瞭解違反組織、自己及他人的道德標準之影響。

說明與補充事項

- **建議擔任此職類/職業之學歷/經驗/或能力條件：**

高中(職)畢業或具一年以上的相關工作經驗。

- **其他補充說明：**

【註 1】金屬雷射切割相關技術工作：指利用雷射光束與物質相互作用的特性對材料進行切割、表面處理、打孔、微加工等工作。